

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-007

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访	
	<input type="checkbox"/> 业绩说明会	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动	
	<input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他		
参与单位	广发证券	国融基金	兴银基金	中泰证券
	嘉实基金	益恒投资	同泰基金	中意资管
	华夏未来资管	九泰基金	国泰基金	中邮证券
	华泰资管	中船财务	全天候投资	东兴基金
	东盈投资	长信基金	途灵资产	中银基金
	兴证资管	浙商证券	交银施罗德基金	圆信永丰基金
	上银基金	源乘基金	宝盈基金	合道资产
	Point 72	华泰证券	盘京投资	景熙资产
	华泰保兴基金	中信证券	百创资本	中金公司
	诺德基金	山西证券	兴业新华资产	朱雀基金
	华泰柏瑞基金	中泰资管	中粮期货	信达澳亚基金
	兴业基金	华能贵诚	国寿安保	天风证券
	富国基金	富安达基金	广发基金	新华资产
	晨燕资产	红土基金	西南证券	路博迈基金
	银河基金	中承东方资产	东吴证券	华夏基金
	东吴基金	华创证券	恒安标准人寿	南京证券
	爱建证券	浦银安盛基金	西部证券	拓璞基金
	阳光资管	华安基金	博时基金	方正证券
	DYMON ASIA	银河证券	西部利得基金	嘉御资本
	中移资本			

活动时间	2025年8月25日	
活动地点	网络会议	
接待人员	职 务	姓 名
	董事、董事会秘书	翁华强
	全球市场副总裁	邵 丹
	投资者关系总监、董事会办公室副主任	孙 远
	证券事务代表	郑星月
	证券事务经理	胡水清
活动主要内容	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2025 年上半年的经营情况。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、AI 浪潮为 DDR5 SPD 市场带来的增量</p> <p>随着大模型训练与推理对算力的迫切需求，AI 服务器的内存配置显著升级，当前主流的 AI 服务器通常需要部署超过 20 根 DDR5 内存模组，是传统通用服务器的 2 倍左右，为市场注入了新的增长动力。此外，受益于 AI PC 等高端应用的加速渗透，以及 LPCAMM2 内存模组可能替代 LPDDR5X 板载内存成为新一代轻薄型笔记本电脑和其他紧凑型设备的理想解决方案（传统的 LPDDR5X 板载内存方案无需使用 SPD 芯片，LPCAMM2 内存模组则需要配套使用 1 颗 DDR5 SPD 芯片），进一步推动了市场需求的增长，为 DDR5 SPD 市场带来了更为广阔的发展空间。</p>	

2、DDR5 SPD 市场的进入壁垒与公司的市场地位

作为通用型芯片，一款合格的 DDR5 SPD 芯片不仅需要在可靠性、寿命、功耗等性能指标满足市场要求，还需要能够兼容市场上种类繁多的系统平台，芯片设计企业需要具备从芯片、应用电路到系统平台等全方位的技术底蕴，才能在行业中立足。此外，DDR5 内存模组市场高度集中，少数头部内存模组厂商占据了绝大部分的市场份额，该等厂商及生态伙伴已与供应商建立起了长期、稳定的合作关系，新进入者若缺乏为同级别客户提供产品的经验，将很难获得客户的信赖。同时，严苛的产品认证环节与漫长的验证周期也使得新进入者面临较高的商业门槛。

在内存模组配套芯片领域，公司拥有近二十年的量产经验。自 DDR2 世代起即研发并销售配套 DDR 内存模组的 SPD 芯片，凭借长期的技术积累、对行业标准的理解以及多年的产品和产业化经验，已建立了明显的技术领先优势，现已发展成为全球 DDR2/3/4/5 SPD 系列芯片的核心供应商。凭借优秀的产品性能、可靠的产品质量、完善的客户服务水平，公司及时把握住 2022 年上半年 DDR4 SPD 芯片供应短缺带来的市场机会，DDR4 SPD 芯片成功导入多家行业头部内存模组厂商，成为国内唯二具备向头部内存模组厂商直接供应配套芯片资质的企业之一。

3、AI 眼镜等智能终端应用展望

根据 Counterpoint 统计，2025 年上半年全球 AI 眼镜的出货量同比增长 110%，眼镜作为唯一尚未被电子产品替代的穿戴产品，如果 AI 眼镜未来能够实现在功能、续航、重量等方面的平衡，有望成为消费电子领域新的增长点。报告期内，公司 WLCSP EEPROM 芯片在市场主要品牌的 AI 眼镜产品中取得大规模应用，出色地满足了 AI 眼镜对于芯片的低功耗和高静电防护能力等性能指标的要求。

与此同时，公司积极把握 AI 向智能终端设备渗透发展所带来的市场发展机会，并通过内生和外延等方式，实现了基于 NORD 工艺平台的覆盖 512Kb-64Mb 容量范围的 NOR Flash 产品组合，以及基于 ETOX 工艺平

台的覆盖 32Mb-512Mb 容量范围的 NOR Flash 产品储备，进一步完善了在消费电子领域的产品布局。未来公司将持续加强对产品的推广、销售及综合服务力度，以及时满足 AI 智能终端普及所带来的存储芯片需求。

4、汽车级 EEPROM 市场的进入壁垒与公司的市场地位

汽车级 EEPROM 芯片的可靠性和稳定性对终端应用而言意义重大，具有鲜明的技术和商业门槛。一方面，芯片设计企业需要与晶圆厂商、封测厂商共同探讨工艺改良与设计创新，并通过长时间的协作、磨合，确保产品的优良品质以及产能的稳定供应。另一方面，芯片设计企业需要经过多年的技术和市场的经验积累，储备大量的修正数据，以确保产品的可靠性和稳定性。因产品验证周期较长，测试费用高昂，客户在选择芯片供应商时极为谨慎，对新产品的导入控制非常严格，一旦选定芯片方案，通常不会轻易进行更换，从而对市场新进入者形成较高的商业壁垒。

在汽车级 EEPROM 竞争领域，目前意法半导体和微芯科技等境外竞争对手已形成较为成熟的汽车级 EEPROM 芯片系列，技术水平和客户资源优势相对明显，境内除公司外则暂无其他成熟、系列化汽车级 EEPROM 芯片供应商。公司在汽车电子和高性能工业应用领域深耕十余年，并及时把握住 2020-2022 年汽车电子“缺芯潮”带来的市场机会，产品成功导入众多国内外主流厂商，市场份额快速提升，成为国内唯一可以提供成熟、系列化汽车级 EEPROM 芯片的供应商。

5、上半年汽车级业务的发展情况

作为国内唯一可以提供成熟系列化汽车级 EEPROM 芯片的供应商，公司上半年积极进行欧洲、美国、日本、韩国、东盟等海外重点市场拓展，汽车级 EEPROM 芯片成功导入多家全球领先的汽车电子 Tier1 供应商，市场份额快速提升，产品的销量和收入较上年同期实现高速增长。此外，公司基于在汽车电子市场的客户资源优势，顺应下游客户同时提出的汽车级 EEPROM 芯片和汽车级 NOR Flash 芯片需求，通过提供组合产品及解决方案等方式，汽车级 NOR Flash 芯片于报告期内成功搭载在多款主流品牌汽车中导入市场，进一步完善了在汽车电子领域的产品布局。

6、高性能工业级存储芯片的业务发展情况

公司在工业应用市场具有较深厚的积累，工业级存储芯片现已广泛应用于工业自动化（如伺服控制、机器人、人机交互）、数字能源（如光储充一体、逆变器）以及通信基站（如高速光模块）等领域，市场份额快速提升，现已发展成为高性能工业级 EEPROM 芯片的领先品牌，与众多全球领先的设备厂商形成了长期稳定的合作关系。同时，公司借助多年运营积累的客户基础，通过多类产品的销售协同，积极推广公司的高性能工业级 NOR Flash 芯片，进一步完善了在工业应用市场的产品布局。

7、音圈马达驱动芯片的业务发展情况

公司是全球领先的开环式音圈马达驱动芯片供应商，并基于在智能手机摄像头模组领域拥有丰富的客户资源和良好的品牌背书，持续向闭环式和光学防抖式驱动芯片等更高附加值的领域拓展。报告期内，公司光学防抖式（OIS）驱动芯片业务取得重要进展，多个规格型号的产品搭载在行业主要智能手机厂商的中高端机机型中实现商用，进一步优化了音圈马达驱动芯片业务的产品结构。

8、上半年的研发投入情况

作为一家技术密集型的科创企业，公司高度重视自主创新，持续扩大研发投入，不断壮大研发人员队伍。公司上半年的研发投入超过 1 亿元，占营业收入的比例近 18%；研发人员数量合计 194 人，较上年同期增加 47 人，研发投入和研发人员数量均创历史新高。

附件清单

无